

精密デバイスの微細接合に最適、コンパクトな超音波接合機



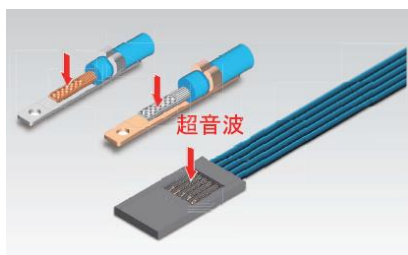
ヘッド荷重	UB050 : 荷重 2~50N、UB300 : 荷重 10~300N、UB500 : 15~500N
ヘッド種類	超音波ヘッド
超音波周波数	周波数 : 30kHz(350W、750W)、40kHz(350W、750W) 、50kHz(160W)
ヘッド制御	荷重、超音波のデジタル制御
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシビ	接合条件 : デジタル設定
	空圧源 : 0.5MPa ドライククリーンエア
ユーティリティ	電源 : 本体 100V10A 発振器 30kHz 100V 5.2,10A、40kHz 100V 5.2A,10A、50kHz 100V2.5A
ユニットサイズ	W400 × D860 × H606mm (本体部)
ユニット重量	150kg

アプリケーション

●被膜細線接合



●ワイヤーハーネス・コネクタ接合

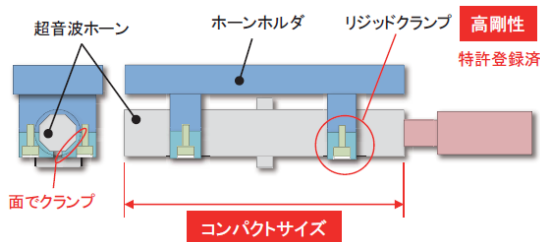


●フレキシブル基板接合



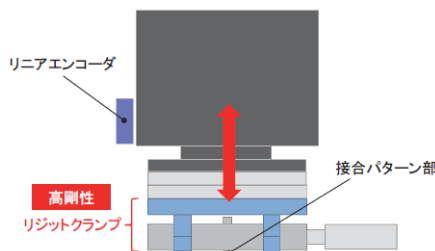
高剛性ホーンクランプ機構

【リジッドクランプ】によって、超音波ホーンをダイレクトにクランプ。これにより超音波ヘッドは高剛性、かつコンパクト。



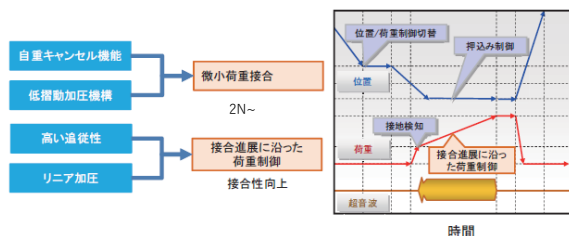
高精度位置制御

接合ヘッド内蔵のリニアエンコーダとリジッドクランプにより高剛性の超音波ホーンユニットで接合部の位置を正確に制御



精密デバイスに最適な高機能荷重制御

低撓動加圧機構による微小荷重接合を実現。接合時の変形に高い追従性を持ち、接合進展と共に荷重をあげるリニア加圧により接合性が向上



充実したプロセスモニタリング機能

装置に内蔵された各種センサ情報により、プロセス動作を詳細に把握でき、プロセス立ち上げ、量産管理に有効。

